

Telit baut Partnerschaft mit Qualcomm Technologies auf Basis neuer LTE-Produkte weiter aus

25.02.2013, 13:11 | IT, New Media & Software

Pressemitteilung von: *Telit*

Mobile World Congress, Barcelona, 25. Februar 2013 – Telit Wireless Solutions, einer der führenden Anbieter von M2M-Lösungen, Produkten und Services, erweitert seine langjährige Zusammenarbeit mit Qualcomm Technologies, einer Tochtergesellschaft von Qualcomm Incorporated. Im Zuge dessen hat Telit ein neues LTE-Modul entwickelt und die Produktvarianten der meistverkauften 3G-Module von Telits xE910-Produktfamilie ausgebaut. Mit diesem umfangreichen Portfolio bietet Telit Formfaktor-kompatible Qualcomm-Lösungen für CDMA, UMTS sowie LTE und adressiert so die Anforderungen von Entwicklern, die M2M-Lösungen und Applikationen für das Internet der Dinge erstellen.

Das neue Telit-Modul LE910 wird auf Qualcomms Gobi MDM9215 basieren und das erste LTE-Modul der xE910-Produktfamilie sein. Gleichzeitig ist das LE910 das zweite LTE-Produkt von Telit; es folgt auf das im letzten Jahr für den Automotive-Markt vorgestellte LTE-Modul LE920.

Im Januar 2013 präsentierte Telit bereits zwei neue xE910-Module für 3G-Lösungen: das UE910 V2 HSDPA mit dem Qualcomm-Chipsatz QSC6270 und das HE910 V2 HSPA+ basierend auf dem Qualcomm-Chipsatz MDM6200. Varianten beider Produkte, die Oracle Java ME Embedded 3.2 unterstützen, befinden sich in der Planung. Ergänzt um das LE910 kann die xE910-Produktfamilie nicht nur die Migration von 2G zu 3G unterstützen, sondern adressiert auch die vielfältigen Möglichkeiten und Einsatzgebiete von LTE.

Der Einsatz der Qualcomm-Chipsets in Telits xE910-Produktfamilie ermöglicht eine Durchlässigkeit von 3GPP2 und CDMA (1xRTT, EV-DO), 3GPP und UMTS (HSDPA, HSPA+) sowie LTE-Varianten. Dies vereinfacht die Anpassung individueller Applikationen an regionale technische Anforderungen, beschleunigt die Markteinführung und reduziert die Total Cost of Ownership.

Am Telit-Stand G70, Halle 5, auf dem Mobile World Congress in Barcelona erhalten Messebesucher in der Qualcomm Technologies Corner einen umfassenden Einblick in das Produktportfolio, einschließlich bereits verfügbarer Produkte und Prototypen sowie den jeweiligen Chipsets. Zu sehen ist dort auch das LE910-Produktkonzept – inklusive einer Reihe kommerziell verfügbarer Module sowie Prototypen für die Automobilindustrie.

„Die erweiterte Partnerschaft mit Qualcomm kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, da wir aus dem M2M-Markt eine verstärkte Nachfrage nach unseren Produkten und Lösungen verzeichnen“, sagt Oozi Cats, CEO von Telit. „Durch den Ausbau unseres Portfolios mit Produkten wie dem LE910-Modul können wir Segmente des 3G- und 4G-Marktes adressieren, die wir zuvor nicht erreicht haben.“

„Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Telit und die Bereitstellung von LTE für CDMA-, HSPA- und HSPA+-Plattformen, die auf Qualcomm-Chipsets basieren“, erklärt Nakul Duggal, Vice President Product Management New Markets bei Qualcomm Technologies. „Qualcomm verfügt über ein umfangreiches Portfolio von 3G- und 4G-Chipsets, unterstützt Telit-Lösungen auf den verschiedenen Produktstufen und adressiert damit die zahlreichen technischen und regionalen Anforderungen von Entwicklern, die M2M-Lösungen und Applikationen für das Internet der Dinge erstellen.“

Bereits seit zehn Jahren ist Telit der M2M-Anbieter mit dem breitesten Hardware-Produktportfolio in den Bereichen Mobilfunk, Short-Range und Positionsbestimmung. In Kombination mit den Services und dem Connectivity-Angebot von m2mAIR ermöglicht Telit Systemintegratoren ein M2M One-Stop-Shopping. Durch die Bereitstellung von Produkten und Services in Bundle-Lösungen mit globalem Support und Logistik-Dienstleistungen können individuelle

Kundenanforderungen erfüllt, technische Risiken beseitigt und die Time-to-Market in das „Internet der Dinge“ reduziert werden.

Diese Presseinformation kann auch unter www.pr-com.de abgerufen werden.

Portrait

Über Telit

Telit Wireless Solutions (<http://www.telit.com/>) (AIM: TCM, gelistet unter Telit Communications PLC), ein weltweit tätiger Enabler von Machine-to-Machine (M2M)-Kommunikation, bietet Mobilfunk- und Short-Range-Module sowie Produkte zur Positionsbestimmung an, außerdem über seinen Geschäftsbereich m2mAIR (<http://www.m2mair.com/>) auch M2M Managed und Value Added Services, einschließlich Connectivity. Damit ermöglicht Telit Anwendern ein M2M One-Stop-Shopping mit Bundles aus Hardware und Value Added Services. Das Unternehmen widmet sich seit mehr als 12 Jahren ausschließlich der M2M-Kommunikation und hat in dieser Zeit seine technologisch führende Rolle mit sechs R&D-Zentren rund um den Globus kontinuierlich ausgebaut. Telit vermarktet seine Produkte und Services in über 80 Ländern.

Mit seinen skalierbaren Lösungen, die zwischen Produktfamilien, Technologien und Produktgenerationen austauschbar sind, kann Telit die Entwicklungskosten seiner Kunden niedrig halten, ihre Design-Investitionen schützen und technische Risiken reduzieren. Telit bietet Kundensupport und Design-Unterstützung über seine 27 Sales und Support Offices (<http://www.telit.com/en/about/company/telit-sales-offices.php#italy>), ein weltweites Netz von Distributoren (<http://www.telit.com/en/products/where-to-buy.php>), mehr als 30 Telit-zertifizierte Kompetenzzentren und das Telit Technical Support Forum (<http://www.telit.com/en/services/technical-forum.php>).

Telit verbindet Unternehmen mit dem Internet der Dinge und ermöglicht ihnen, Daten drahtlos bidirektional zu übermitteln und zu verarbeiten. Unternehmen werden damit effizienter und erschließen sich neue Umsatzmöglichkeiten. Außerdem ergeben sich dadurch zahlreiche sozioökonomische und persönliche Vorteile.

Weitere Informationen zu Telit gibt es unter www.telit.com. Aktuelle Neuigkeiten zu Telit und innovativen Lösungen von Kunden sind unter Twitter (www.telit.com/twitter) und auf Facebook (www.telit.com/facebook) verfügbar.

Copyright © 2013 Telit Communication PLC. Alle Rechte vorbehalten. Telit, Telit Wireless Solutions, Telit Communication PLC, [telit.com](http://www.telit.com), [telit2market](http://www.telit2market.com), Telit Technical Forum, m2mAIR, [m2mAIR.com](http://www.m2mair.com) und alle damit verbundenen Logos sind Marken der Telit Communications PLC in den USA und anderen Ländern. Andere verwendete Namen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Qualcomm und Gobi sind Trademarks von Qualcomm Incorporated, registriert in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Alle Trademarks von Qualcomm Incorporated werden mit Genehmigung verwendet.

Weitere hier verwendete Namen sind möglicherweise Marken der jeweiligen Eigentümer.

News-ID: 700665 • Views: 789 (Stand: 03.10.2026)

Link zur Pressemitteilung:

<https://www.openpr.de/news/700665/Telit-baut-Partnerschaft-mit-Qualcomm-Technologies-auf-Basis-neuer-LTE-Produkte-weiter-aus.html>